



Memoria RAM DDR4 / 8 GB / 3200 MHz / CL19 / Intel XMP 2.0 / Perfil Bajo 31.25 mm (1.23 in) / Disipador Armor Blanco

SKU: HS-C408-U32E2/8G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Memorias RAM

\$1,502.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo de memoria DDR4 UDIMM de 8 GB diseñado para estaciones de trabajo de edición de video y builds de gaming competitivo que demandan ancho de banda sostenido. Opera a 3200 MHz con latencia CAS CL19, eliminando restricciones de transferencia entre CPU y GPU en escenarios de alta carga. Incorpora disipador Armor de aluminio blanco que mejora la estabilidad térmica bajo operación continua. Perfil de altura reducida de 31.25 mm (1.23 in) que garantiza compatibilidad mecánica con disipadores de torre de gran tamaño. Soporta perfil Intel XMP 2.0 para configuración automática de frecuencia y latencia desde la BIOS sin ajustes manuales de voltaje o timing.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo: DDR4 UDIMM de 288 pinesCapacidad: 8 GBFrecuencia: 3200 MHzLatencia CAS: CL19Perfil XMP: Intel XMP 2.0Disipador: Armor de aluminio, color blancoAltura del módulo: 31.25 mm (1.23 in)Temperatura máxima de operación: 85 °CCompatibilidad: Plataformas Intel y AMD recientes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estándar: DDR4Frecuencia: 3200 MHzLatencia CAS: CL19Perfil XMP: Intel XMP 2.0Temperatura máxima: 85 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Formato: UDIMM 288 pinesCapacidad: 8 GBAltura del módulo: 31.25 mm (1.23 in)Disipador: Armor de aluminio blanco</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Módulo de memoria DDR4 8 GB / 3200 MHz</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Overclocking automático Intel XMP 2.0 con un clic en BIOS
Característica 2	Latencia CL19 para respuesta inmediata en cargas pesadas
Característica 3	Disipador Armor de aluminio blanco para estabilidad térmica
Característica 4	Perfil bajo 31.25 mm compatible con coolers de torre grandes
Característica 5	Ancho de banda DDR4 3200 MHz sin cuellos de botella en GPU y CPU
Característica 6	Compatibilidad nativa con plataformas Intel y AMD recientes